



-bles con las siguientes ventajas sobre lo actualmen-
te conocido :

a.- Perfecta impermeabilidad y gran resistencia
a los agentes atmosféricos.

5. b.- Fabricación muy rápida por el fácil moldeo de
sus elementos componentes, que abaratan extraordinaria-
mente el costo.

c.- Su poco peso posibilita su montaje sobre ele-
mentos-soporte de metales ligeros o de madera, con mí-
nimas secciones y construcción elemental.

d.- Es susceptible de ser realizado en cuales-
quiera configuraciones o tamaños previamente determina-
dos.

e.- Posibilita que, el elemento a moldear, sea
15. previamente dispuesto o decorado con cuantas tonalida-
des sean requeridas para ello, no encareciendo en modo
alguno la operación final de moldeo y alineado de bordes.

f.- No son precisas operaciones finales de reto-
que, conformado y enfriamiento.

20. g.- Es susceptible de ser realizado en alto o ba-
jo relieve, indistinta o conjuntamente.

En el adjunto plano, se ha representado, para fa-
cilidad de la descripción, a título de ejemplo y sin ca-
rácter limitativo alguno, por lo tanto, una forma prefe-
rida de realización del objeto de la solicitud.

25. La figura 1 representa el elemento laminar, de di-
mensiones y espesor previamente determinados.

La figura 2 representa el elemento laminar plas-
tificado que ha sido serigrafiado, por una de sus su-
perficie o planos, con el motivo y dimensiones previa-

30.



414439

-mente fijados.

La figura 3 representa el elemento de la figura 2 ya moldeado en el o los relieves requeridos, a su salida de moldeo.

5. La figura 4 representa el elemento moldeado de la figura 3 en su final de perfilado de bordes.

Como puede apreciarse, este procedimiento consiste esencialmente en que en una primera fase se procede a la preparación de un elemento laminar plastificado, de normal existencia en el mercado, en el espesor convenientemente fijado, el cual es preparado para ser serigrafiado por una de sus caras o superficie, con el o con los motivos en que habrá de quedar conformado.

10. Para ello, es preciso que previamente se determinen la o las superficies que habrá de aparecer moldeadas en relieve y sometida o sometidas a la operación de serigrafiado mediante una laca coloreada en la tonalidad requerida.

15. Esta laca es de alto poder adhesivo sobre superficies plastificadas y posee asimismo gran resistencia térmica y antihumídica, estando caracterizada por una gran elasticidad.

20. Se deposita la laca sobre la superficie laminar en un espesor convenientemente previsto y de forma uniforme.

25. Tras ello y en una segunda fase, se procede a un precalentamiento de la placa laminar en un horno adecuado a tal fin y cuya temperatura es elevada gradual y automáticamente hasta alcanzar entre unos 140° a 160° C,

30.

414439



o más, según espesores y calidades, manteniéndola en dicha graduación de temperatura el tiempo necesario para lograr un perfecto moldeo.

5. En la tercera fase se sitúa dicha placa laminar, por la cara serigrafiada, sobre el molde dispuesto a tal fin, y que presenta inferiormente un pisa elástico y la parte embutidora o macho, estando dispuesto el pisa con los elementos necesarios de centrado y guiado.
10. Este pisa rodea, total o parcialmente, el macho conformador o embutidor, y el molde, en su parte superior dispone de un segundo pisa de características similares al inferior, siendo susceptible de que las presiones de ambos pisas sean iguales o distintas.
15. El pisa superior rodea asimismo a la matriz conformadora, que posee el juego o huelgo preciso al espesor de la placa laminar, mas las tolerancias de fabricación y deslizamiento. El molde ya citado, va situado y ligado a una prensa hidráulica, provista
20. de cierre automático, controles de velocidad, presión, y temperatura.
25. Situada la placa laminar de la forma antedicha, se verifica el cierre del molde, estando dicha placa a la temperatura prevista, siendo ésta pisada entre ambos pisas que la sujetan a la presión convenientemente predeterminada, continuando dicho molde su carrera de descenso en cuyo momento, y tiempo preciso, comienza a verificarse el moldeo por embutición, hasta alcanzar su fin de carrera, en cuyo momento y mediante un temporizador, se provoca un cerramiento fi-
- 30.



-nal o golpe de sentado y conformación, tras lo que se mantiene el tiempo previsto de un primer enfriamiento provocativo de la rigidez necesaria para que la placa moldeada no pueda sufrir ninguna deformación.

5. Se procede luego a la apertura del molde, provocando su retroceso durante el cual y hasta tanto no estén desligados la matriz y punzón, los pisas permanecen en presión entre ambos, teniendo prendida la parte laminar destinada a ello. Verificada la apertura

10. total, la placa laminar queda superpuesta sobre la parte inferior del molde y desligada del macho conformador, siendo susceptible en dicho momento, su traslado manual o mecánico al lugar de enfriamiento total, no siendo ya precisa ninguna otra operación de preparación, serigrafiado o moldeado.

15. Una eventual operación de perfilado de bordes, provoca la terminación total del procedimiento.

Asímismo, se hace constar que este procedimiento puede ser objeto de cualesquiera modificaciones de detalle en tanto que éstas no alteren su fundamento.

 N O T A

Los puntos esenciales que se reivindican para que sean objeto de esta Patente de Invencion, en España, por veinte años, son los siguientes :

25. 1.- Procedimiento de acabado en materiales moldeables, caracterizado porque se procede a la preparación en una primera fase, de un elemento laminar plastificado, el cual es sometido por una de sus caras o superficies, a serigrafiado con el motivo y colores previstos, mediante lacas de alta re-

30.

414439

-5M



- sistencia térmica, húmedica y elástica, siendo sometida posteriormente, esta placa o lámina a un secado rápido por aire a temperatura adecuada, tras lo que, en una segunda fase, se eleva hasta alcanzar los 140º a 160º C, procediéndose luego, en una tercera fase, a la operación de conformación en relieve, mediante moldeado en caliente de los motivos serigrafiados, sufriendo un proceso preliminar de enfriamiento, antes de su desmoldeo.
- 5.
- 2.- Procedimiento de acabado en materiales moldeables, según reivindicación anterior, caracterizado porque la cara o superficie serigrafiada, es la opuesta a los relieves moldeados.
- 10.
- 3.- PROCEDIMIENTO DE ACABADO EN MATERIALES MOLDEABLES.
- 15.
- Todo ello, tal y como se describe en la Memoria que antecede y se representa en el plano adjunto y a los fines indicados.
- Consta la presente Memoria Descriptiva de seis hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y de una hoja de dibujos.
- 20.

Madrid, 5 de Mayo de 1.973.

MEGAPLAS, S.A.

P. A.

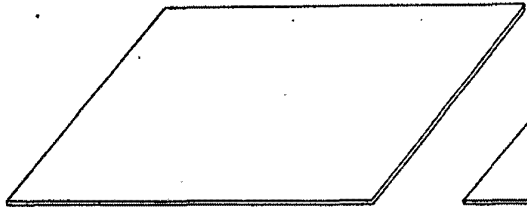


FIG. 1

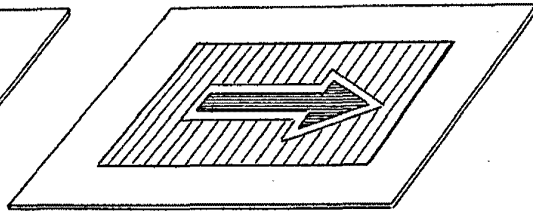


FIG. 2

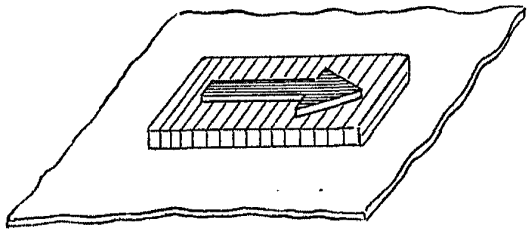


FIG. 3

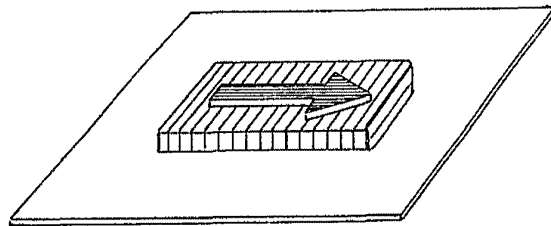


FIG. 4

Madrid. 5 de Mayo de 1.973.
MEGAPLAS S.A.
P.P.